

# Produktdatenblatt

DIN 41612 Federleiste gerade Bauform F,  
Art. Nr. 110-60024

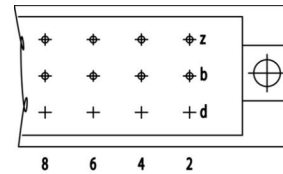
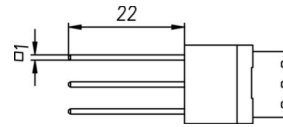


Abbildung ähnlich



Parallel



Rechtwinklig



Einpresstechnik



Power



Rugged

- Anschlusslänge 22 mm
- Anschlussseite Sn-beschichtet für Wire Wrap
- Polzahl 32
- Einpresstechnik
- Gütestufe 2



» zum Produkt auf [www.ept.de](http://www.ept.de)



» zur Produktgruppe DIN 41612

# Produktdatenblatt

DIN 41612 Federleiste gerade Bauform F,  
Art. Nr. 110-60024



## Technische Daten

### Grundlagen

Spezifikation	IEC 60603-2 (DIN 41612)
Gütestufe	2
Anzahl Kontakte	32
Anschluss technik	Einpresstechnik
Anschlusslänge	22 mm
Leiterplattenabstand	34.1 mm
Betriebstemperatur	-55°C bis +125°C

### Material

Isolierkörper	PBT glasfaserverstärkt, UL 94 V-0
CTI Wert <i>IEC 60112</i>	200
Kontaktmaterial	Kupferlegierung

### Mechanisch

Rastermaß	5.08 x 3.81 mm
Steckkraft	< 50 N
Ziehkraft pro Kontakt	> 0.2 N
Lebensdauer	400 Steckzyklen

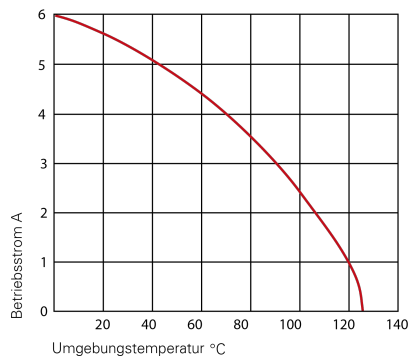
### Elektrisch

Betriebsstrom	5.6 A
Durchgangswiderstand	< 15 mΩ
Luft- und Kriechstrecke	K: ≥ 3.0 mm, L: ≥ 1.6 mm
Isolationswiderstand	> 10 <sup>6</sup> MΩ
Prüfspannung	1550 V

### Zulassungen / Konformität

UL file	E130314
Umwelt	RoHS konform

### Derating Diagramm

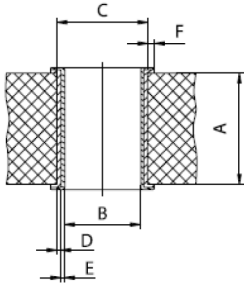


#### Bauform D, E, F, G

20 °C	5,6 A
70 °C	4,0 A
100 °C	2,5 A

### Lochspezifikation

Schichtaufbau nach IEC 60352-5



Material	chem. Sn Leiterplatten
<b>Nennloch</b>	<b>Ø 1.6 mm</b>
<b>A Leiterplattendicke</b>	min 1.44 mm
<b>B Endloch</b>	Ø 1.6 +0.09 / -0.06 mm
<b>C Grundbohrung</b>	1.75 ±0.025 mm
<b>D Cu Schicht</b>	min. 25 µm
<b>E Oberfläche</b>	chem. Sn Schicht, max. 1.5 µm
<b>F Restring</b>	min. 0.1 mm

Material	Ni, Au Leiterplatten
<b>Nennloch</b>	<b>Ø 1.6 mm</b>
<b>A Leiterplattendicke</b>	min 1.44 mm
<b>B Endloch</b>	Ø 1.6 +0.09 / -0.06 mm
<b>C Grundbohrung</b>	1.75 ±0.025 mm
<b>D Cu Schicht</b>	min. 25 µm
<b>E Oberfläche</b>	Ni, Au Schicht, 0.05 - 0.2 µm Au über 2.5 - 5 µm Ni
<b>F Restring</b>	min. 0.1 mm

Material	rein Cu Leiterplatten
<b>Nennloch</b>	<b>Ø 1.6 mm</b>
<b>A Leiterplattendicke</b>	min 1.44 mm
<b>B Endloch</b>	Ø 1.6 +0.09 / -0.06 mm
<b>C Grundbohrung</b>	1.75 ±0.025 mm
<b>D Cu Schicht</b>	min. 25 µm
<b>E Oberfläche</b>	OSP*, z.B. GLICOAT-SMD (F2) mit 0.12 - 0.15 µm
<b>F Restring</b>	min. 0.1 mm

Material	HAL Sn Leiterplatten
<b>Nennloch</b>	<b>Ø 1.6 mm</b>
<b>A Leiterplattendicke</b>	min 1.44 mm
<b>B Endloch</b>	Ø 1.6 +0.09 / -0.06 mm
<b>C Grundbohrung</b>	1.75 ±0.025 mm
<b>D Cu Schicht</b>	min. 25 µm
<b>E Oberfläche</b>	HAL Sn, 5 - 15 µm
<b>F Restring</b>	min. 0.1 mm

# Produktdatenblatt

DIN 41612 Federleiste gerade Bauform F,  
Art. Nr. 110-60024

---



## Modifikationen

Auf Anfrage erhalten Sie von uns auch

- ohne Befestigungsflansch
- Sonderlänge für Anschlüsse
- Gütestufen I + III oder kundenspezifisch
- Sonderbestückung

## Zeichnungen

Die Kundenzeichnung zu diesem Produkt erhalten Sie auf Anfrage unter [sales@ept.de](mailto:sales@ept.de)